



**TIS™300** 系列拥有高屏蔽效能, 是设计来替代价格较高的银添加物。镍/石墨添加物不单只可以提供良好的导电性能, 还可以有吸收电波的能力。

**TIS™300** 系列产品是铝铸压件或金属镀层的基材最理想的搭配。TIS™300 的材质有抗流电所产生的腐蚀, 并在严苛的环境下保持其稳定性。

## 特性

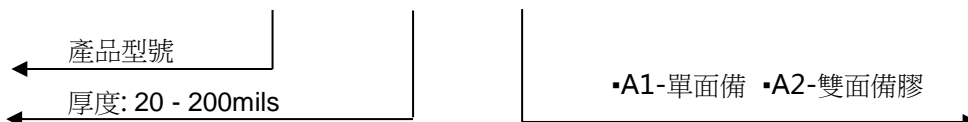
- 》良好热传导率: 2.0W/mK
- 》表面电阻率 (Ohm - cm) : 1↓
- 》高可压缩性, 柔软兼有弹性, 适合于在低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

## 产品应用

- 》3C产品噪音抑制
- 》RAM高次谐波干扰的吸收
- 》Wifi信号改善
- 》手机等信号模式转换的错误率
- 》FPC IC和其他电子器件的组件, 如笔记本电脑、平板电脑等电磁元件噪声抑制

TIS300导电硅胶片			
性能指标	单位	典型值	测试方法
颜色	NA	灰色	目视
成分/结构	NA	石墨镀镍填充硅橡胶	*****
厚度	mm	0.020"-0.200" 0.50mm - 5.00mm	ASTM D751
产品厚度公差	mm	±10%	*****
密度	g/cc	2.5	ASTM D297
表面电阻率	Ohm - cm	1↓	ASTM D257
硬度	Shore 00	65 + 5	ASTM D2240
导热系数	W/mK	2.0	ASTM D5470
抗张强度	psi	30	ASTM D412
撕裂强度	lb/in	6	ASTM D412
阻燃等级	/	94V0	E331100
工作温度范围	°C	-40 to +150	*****

產品標識 → **TIS3 - 80 - A1**



標準片料尺寸 & 厚度: 10" x 16"(254mm x 406mm) TIS™ 系列可模切成不同形狀提供。  
如需不同厚度請與本公司聯繫。

